公司代码:603893　　公司简称:瑞芯微

瑞芯微电子股份有限公司

2021 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2021年度利润分配预案为:以2021年度利润分配预案实施股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利8.50元(含税),预计派发现金红利总额为354,663,520.00元,资本公积不转增。公司2021年度利润分配预案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过,本次分配预案还须经股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	瑞芯微	603893	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	林玉秋	翁晶
办公地址	福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园A区18号楼	福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园A区18号楼
电话	0591-86252506	0591-86252506
电子信箱	ir@rock-chips.com	ir@rock-chips.com

2 报告期公司主要业务简介

1.行业基本情况

根据中国证监会《上市公司行业分类指引(2012年修订)》的行业划分,公司所处行业属于计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)。

集成电路行业作为全球信息产业的基础,集成电路产品的广泛应用推动了信息和智能设备的发展,已成为现代日常生活中必不可少的组成部分。近年来5G应用、汽车电子、数据中心服务器、人工智能应用、智能支付、云计算、虚拟现实和增强现实(AR/VR)以及可穿戴设备等应用领域的逐步成熟和发展驱动了集成电路市场的加速发展。

下游需求增长、上游供应紧缺,是2021年半导体行业的主题。本轮芯片短缺的根本原因是需求与供给的不匹配,疫情、自然灾害、地缘政治等原因加剧了供需不平衡。AIoT 产业是多种技术融合,赋能各行业的产业,整体市场潜在空间巨大,场景多样化。世界半导体贸易统计组织(WSTS)指出,新冠肺炎疫情推开居家办公及远距线上教学所需的PC及平板销售,宅经济需求扩大,同时智能手机转向5G换机,网络数据通信量呈现"跃性增长,云端服务等基础设施设备投资攀升,加上车用及工业等芯片缺货,带动2021年半导体需求大增。

2.公司所处的行业地位

公司是中国领先的AIoT芯片设计公司,获得高新技术企业、国家企业技术中心的认定,拥有二十年深厚的技术底蕴和丰富的行业市场经验。公司以客户需求为导向,以技术创新为核心,围绕"大音频、大视频、大感知、大软件"的技术总体方向,在不同的应用领域全面布局。经过二十多年的创新发展,公司在高性能芯片设计、图像信号处理、高清视频编解码、人工智能及系统软件等开发上具有丰富的经验和技术储备,形成了多层次、多平台、多场景的专业解决方案,下游应用涵盖各种新兴智能硬件,尤其是近年来快速发展的AIoT应用领域。

报告期内,公司荣获第十六届"中国芯"优秀市场表现产品奖。从2006年第一届"中国芯"评选开始,公司是国内每年都荣获"中国芯"奖项的少数两家芯片设计公司之一。公司还被评选为"2021年度中国安防十大影响力品牌"、2021 CPSE安博会产品评选最高荣誉"金鼎奖"等。

3.行业和关政策

2021年,两会发布《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》,提出加强关键数字技术创新应用,聚焦高端芯片、操作系统、人工智能关键算法、传感器等关键领域,加快推进基础理论、基础算法、装备材料等研发突破与迭代应用。加强通用处理器、云计算系统和软件核心技术一体化研发。

2021年,福建省人民政府发布《福建省"十四五"制造业高质量发展专项规划》提出,突出"增芯强屏"延链补链发展,重点发展特色专用芯片、柔性显示、LED、自主计算机整机制造及以5G为牵引的网络通信等领域,深入实施数字经济创新发展工程,加快数字产业化进程,培育壮大大数据、物联网、人工智能等新一代信息技术产业。发挥联芯、士兰微、瑞芯微等重点企业作用,加快发展高端芯片,突破28纳米以下先进制程工艺,推动MEMS传感器生产线建成投产。发展特色集成电路设计业,重点开展智能物联等新一代信息技术应用芯片研发,推进集成电路企业和研发机构移植使用国产软件工具,引导芯片设计与应用结合,着力提升消费电子领域芯片设计竞争力。

为推动集成电路行业发展,国家及地方均出台支持政策,为行业健康发展保驾护航。

(一)公司主营业务情况

瑞芯微主要致力于大规模集成电路及应用方案的设计、开发和销售,在大规模SoC芯片设计、数模混合芯片设计、图像信号处理、高清视频编解码、人工智能及系统软件开发上具有丰富的经验和技术储备,形成了多层次、多平台、多场景的专业解决方案,赋能智能硬件、机器视觉、行业应用、消费电子、汽车电子等多元领域。

公司的主要产品智能应用处理器芯片,是SoC芯片的一种,属系统级的超大规模数字IC,SoC芯片实际上需要芯片设计公司具备综合研发能力,即"十全大武功"。在数字技术上,需要音频、视频、ISP编码的算法、算法的硬化;在体系架构上,需要比较完美的解决存储、数据流通、数据结构的问题,其中成系统最关键的是多电源域、功耗处理,因此公司还日研了支持各种驱动的软件,CPU、GPU的算法。这一特点也提高了SoC的行业门槛。

近年来,公司大力研发AIoT产品、开拓相关市场,积极打造AIoT生态,推广和发展人工智能技术在各个行业的应用,已经成为国内领先的AIoT芯片供应商。

(二)公司主要产品及应用领域

公司产品涵盖智能应用处理器芯片、数模混合芯片、接口转换芯片、无线连接芯片及与自研芯片相关的模组产品等,并为客户提供技术服务。

表:公司主要产品系列及主要应用领域

类别	子类	主要特点	主要产品系列	主要应用领域
智能应用处理器芯片	高性能应用处理器	采用高性能CPU和GPU内核,新一代芯片还增加了NPU处理单元,具有强大的多媒体处理能力,以及众多外设接口,可以适应众多复杂场景应用的需求,可以运行Android、Linux等操作系统,是公司的代表性产品。	RK3588 系列	ARM PC、平板、高端摄像头、NVR、8K和大屏设备、汽车智能座舱、云服务设备及边缘计算、AR/VR等
			RK3399系列	无人机、人脸识别及支付、开发板及工控、ARM服务器、视频会议系统、商业显示、行业平板和电子白板、自助设备等
			RK3288系列	商业显示、收银机、人脸识别及测温、行业平板、开发板及工控、自助设备、云终端、电话手表、汽车电子、视频会议系统等
			RK3568/RK3566系列	平板电脑、NVR、NAS、电话手表、云终端、网关等
	通用应用处理器	具有适当的处理能力,价格适中,适合消费电子及一般控制类产品的需求。	RK3368系列	教育电子、收银机、智能家电、智能门禁等
			RK3326系列	平板电脑、智能音箱、扫地机器人、翻译笔、家居中控等
			RK3188系列	平板电脑、工控板、云终端等
			RK312X系列	平板电脑、数码相框等
	机器视觉处理器	具有良好的影像处理能力,以及AI/视觉处理能力,无属形处理能力,适用于多场景下的机器视觉和AI运算的应用。	RV1109/RV1126系列	安防摄像头、人脸门禁、行车记录仪等
			RK180X系列	边缘计算等
			RV1108系列	扫地机器人、行车记录仪、智能门禁等
			RK16XX系列	结构光模组产品、智能门禁、视觉增强等
	智能语音处理器	具有丰富的语音外设及控制接口的处理器,弱属形能力,适合智能语音、智能设备、嵌入式因公	RK3308系列	扫地机器人、智能语音设备、智能音箱、工业控制等
	工规处理器	符合工业高低温场景和高可靠性的芯片	RK3358J,RK3568J	工业应用
	车载处理器	符合车载应用的高低温场景及高可靠性的芯片	PX系列,RK3358M RK3568M	汽车仪表,汽车中控等
	流媒体处理器	突出流媒体处理的应用处理器	RK3328系列	电视盒子等
			RK322X系列	电视盒子等
			RK3036系列	视频投屏器等
专用微处理器	语音微处理器	MCU类产品,适合语音或音频等专用的嵌入式应用	RK2206系列、RK2108系列、Nano系列	语音处理、音频播放器等
数模混合芯片	电源管理芯片	内置多路LDO和DCDC等电源,并具有数字控制电路,能精准控制上电时序和输出电压,用于SoC系统的复杂供电。	RK80X 系列、RK81X系列	处理器配套电源管理芯片
	快充协议芯片	内置ADC,比较器等高精度模拟电路,并有数字控制电路,能准确控制电池大电流充电	RK82X 系列、RK83X系列	快充应用
其他芯片	接口及无线芯片		RK6XX、RK9XX、RK10XX系列	显示等接口转换,音频数模转换及无线连接芯片,主要是SoC芯片的配套使用
组件	开源平台硬件(开发板)、人工智能计算棒、结构光模组		RK3288 EVB开发板、RK3399 EVB开发板等;RK1808计算棒;RMSL201/RM-SL205/RMSL312等结构光模组	学习和评估平台,小批量嵌入式应用;人工智能边缘计算;人脸支付、3D感知;工业控制平板等

1.智能应用处理器芯片

公司的智能应用处理器芯片均为系统级的超大规模数字集成电路,即SoC,可以分为高性能应用处理器、通用应用处理器、人工智能视觉处理器、智能语音处理器、车载处理器、流媒体处理器。上述处理器一般内置中央处理器(CPU),根据使用场景的需要增加图形处理器(GPU)、图像信号处理器(ISP)、神经网络处理器(NPU)及多媒体视频编解码器等处理内核。芯片内部设置高速总线负责各个处理器和外部接口的数据传输。配备内存接口、动态存储器接口、显示接口、网络接口以及各种高速、低速外部设备接口。

SoC的关键技术主要包括总线架构技术、IP核可复用技术、软硬件协同设计技术、SoC验证技术、可测性设计技术、低功耗设计技术、超深亚微米电路实现技术,以及嵌入式软件移植、开发研究,是一门跨学科的研究领域。SoC意味着在单个芯片上实现以前需要多个芯片才能实现的系统功能,克服了多芯片板级集成出现的设计复杂、可靠性差、性能低等问题,并且在减小尺寸、降低成本、降低功耗、易于开发等方面也有突出优势。SoC对研发设计、制造工艺以及软硬件协同开发技术的要求较高,主要体现在芯片验证和测试难度的提高,以及IP复用、混合电路设计的困难加大。任何SoC的设计都是性能、功耗、稳定性、工艺难度几方面的平衡。

完整的SoC系统解决方案,除了提供硬件参考设计外,还需要提供系统级的软件参考设计,包括驱动软件、大型OS(Linux、Android、ChromeOS、国产OS等)的移植,针对性的算法、中间件和上层应用软件的适配等,并通过严格的可靠性、兼容性测试。

公司的SoC芯片主要应用于智能物联和消费类电子两个领域,既包含传统的电子产业,也应用于新兴的AIoT产业。AIoT产业包含"云、晋、边、端、用、服务"板块。公司SoC产品主要应用于端侧,作为设备的大脑,执行AI算法、输入输出,用户交互等功能,是端侧产品的核心部件。公司部分中高端芯片也用于边侧的小型服务器,对高速数据处理能力和安全性提出了更高要求的压力。公司也与云服务客户合作,高端芯片作为云服务服务器的核心处理器,承担模拟器、AI分析等功能。

智能物联面向商业、金融、教育、办公、政务、汽车、工业等领域,主要产品形态包含商业标牌显示、金融收银机具、教育设备、办公会议系统、安防前后端产品、车载娱乐系统、工业控制器等。近年来,公司积极研发新产品,并向安防监控、工业应用、汽车应用市场渗透,满足各个产业AI化升级需求,取得阶段性成果。

消费电子面向个人消费者,产品形态涵盖扫地机器人、词典笔、智能音箱、智能家电、平板电脑、电视盒子等智能硬件产品。公司的AIoT芯片满足了消费电子智能化升级需求,可以实现智能语音、智能AI处理等新兴技能,极大提升用户体验并推动行业发展。

公司主要应用处理器产品详细介绍如下:

(1)高性能应用处理器

公司的高性能应用处理器,采用ARM旗舰级别CPU、高性能GPU,以及公司自研的高算力NPU,形成可处理复杂任务的核心,结合强大的多媒体能力以及丰富的外设接口,可实现不同场景下的应用。

与常见的手机移动处理器相比,公司的高性能处理器在同样具有高性能计算内核、低功耗特性外,还添加了丰富的外设接口,不仅可应用于平板类型的移动计算设备,还适用于如电脑、商业显示设备、金融支付机具、人工智能设备、云服务等产品。

2021年,公司新的高性能旗舰处理器RK3588面世,该芯片弥补国内高性能通用处理器的空白,其强大的通用和AI运算能力进一步促进各个行业的发展。

(2)机器视觉处理器

公司于2020年推出新一代智能视觉处理器RV1109/RV1126,于2021年推出高端智能视觉处理器RK3588,两款产品已经得到行业头部客户的肯定。在不断开拓市场同时,公司在2021年又启动研发新一代智能视觉处理器项目,定位于机器视觉规模最大的主流赛道,通过多款产品的高低组合,公司将形成品类齐全的视觉处理器系列,在智能家居、智能硬件、机器视觉上形成更有竞争力的解决方案,为客户创造更多的价值。

公司已逐步形成完整的AIoT软硬件整体方案,除了人工智能运算核心外,公司同样重视相关的配套技术和解决方案的研发,包括4K高动态图像处理、低时流高清视频编码、多麦克风降列处理、人工智能开发调试套件等技术,实现高清感知、高清认知的完整技术路线,逐步形成了完整的AIoT产品及方案体系。

(3)车载处理器

2021年1月,公司推出首颗通过AEC-Q100车用可靠性标准测试的芯片RK3358M。RK3568M已经在认证的过程中,即将在2022年上半年完成AEC-Q100测试。12月推出的新款高性能处理器RK3588也将进入汽车电子领域,针对高性能智能座舱的应用。公司的机器视觉处理器也已在不同种类汽车的DMS、DVR系统中得到应用。

目前,公司已形成高中低多档次、不同性能的车用处理器解决方案,涵盖乘用车、商用车等领域的应用。公司还将布局更多种类的车载芯片,如车用音频芯片,接口芯片已经在研发中,在未来进一步丰富公司的车载处理器系列产品。

2.模数混合芯片

公司的模数混合芯片产品包括电源管理芯片、快充协议芯片、多媒体接口和无线芯片等芯片。这些芯片完成特定的功能,一般在整机中起辅助作用。

电源管理芯片是承担对电能的变换、分配、检测及其他电能管理职责的芯片。公司现有电源管理芯片主要有与公司应用处理器芯片相配套的电源管理芯片和快充协议芯片。报告期内,公司持续进行电源管理芯片和快充协议芯片的研发。

电源管理芯片,与公司的应用处理器配套形成完整的硬件设计方案。主要包括电源变换电路、低压差线性稳压器、上电时序管理以及电压控制等电路,根据应用的需要,部分电源管理芯片还集成电池充电管理、电量测量等功能,是集成模拟电源芯片和数字逻辑管理的数模混合电路。

快充协议芯片,主要由电压检测、电流检测、恒流恒压管理、MCU和通讯端口组成。快充协议芯片可以分为适配器协议芯片和手机端协议芯片两种。公司目前已有手机专用适配器芯片、手机专用终端芯片以及多协议快充适配器芯片三种细分产品系列。

公司的其他芯片还包括指针对特定功能而设计的特殊应用的ASIC芯片,具体为接口转换芯片、无线连接芯片、MCU芯片等,用于实现显示接口扩展、无线连接、音频播放等功能,这些芯片和公司的智能应用器,形成配套,增强公司解决方案的竞争力。同时公司也积极开拓外部市场,形成有竞争力和规模效益的核心产品线。

(三)公司项目研发情况

2021年,公司投入的研发费用为560,859,120.85元,占营业收入比例达20.63%,同比增长49.03%。公司重点研发情况如下:

1.完成高端旗舰芯片RK3588的设计和验证工作

公司的高端旗舰芯片RK3588于2021年上半年完成芯片设计并成功流片。2021年12月,在公司举办的第六届开发者大会上正式发布RK3588芯片,并展出基于RK3588的各款演示样机。

该芯片采用先进Fin-FET制程,内置ARM 4核A76和4核A55 CPU,4核ARM G610 GPU,以及自研的6T算力NPU;支持高速的64bit LPDDR4/LPDDR5内存,以及大容量存储器接口,满足各种应用下的存储需求;在多媒体上,具备8K多格式视频编码器、解码器及48M图像信号处理器,并具有8K显示以及多路4K显示能力,最多6路摄像头输入处理能力;在高速外设接口上,具备多路USB3.1、PCI-e、SATA以及以太网接口,可以实现5G、WiFi 6、万兆以太网以及更复杂的连接。

RK3588是公司新一代通用旗舰AIoT芯片,规格上涵盖PC、智能硬件、视觉处理、车载处理的各种需求,以高算力、高性能多媒体处理、高可扩展性为特点,适用于高性能平板、ARM PC、智能座舱、多目摄像头、智能NVR、智慧大屏/多屏应用、云服务及边缘计算、VR/AR等应用领域。该芯片的面世,进一步夯实了公司AIoT产品线的布局,表明公司的技术研发能力进一步提升,将极大提进公司业务和市场的发展。

2.加快现有产品更新迭代

为缓解"缺芯"状态,公司积极布局新产品项目,加快现有产品更新迭代,有效扩大公司的供应能力。报告期内,公司完成两个基于28nm工艺制程的处理器芯片项目设计,其中一个项目的产品已形成大批量供应,此外还针对多个不同工艺制程的芯片,进行了升级。

3.进行新一代视觉处理器芯片的研发

该项目针对主流视觉处理市场,在NPU、ISP、视频编码、音频处理等方面的处理性能和效果均有显著提升,其具有高集成度、高性价比、低待机功耗的特点,可以实现多场景的视觉处理,将助力AIoT产业及产品的研发及落地,并进一步扩展公司在视觉和AIoT市场的占有率和客户面。

4.持续研发基础核心IP

报告期内,公司持续研发基础核心IP,尤其在NPU、ISP、高性能视频编解码、视频后处理等方向不断更新迭代。公司第三代ISP以及第四代NPU均已研发完成,并应用到相关芯片中。此外,根据实际应用产品反馈,公司不断扩展NPU支持网络的类型,对接各类AI客户,逐步形成完善的嵌入式人工智能技术链路和应用生态。

5.持续研发处理器周边芯片

处理器周边芯片,包括电源芯片、无线芯片、以及接口转换芯片等等。这类芯片具有投资周期短,生命周期长,维护成本低等特点,可以和公司的处理器形成"阴阳互辅"关系。

报告期内,公司持续研发处理器周边芯片,逐步完善技术和产品线。新款高性能、高集成度的电源管理芯片已成功配套公司旗舰处理器RK3588。在2021年度,公司研发了新一代WIFI无线芯片、快充协议芯片、电源管理芯片以及多媒体接口、音频编解码等芯片。前述芯片预计在2022年进入批量供应,进一步完善公司产品线布局,提升经营业绩。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	3,378,707,945.06	2,718,422,251.63	24.29	2,064,011,166.09
归属于上市公司股东的净资产	2,850,578,033.95	2,260,803,296.12	26.09	1,715,960,219.49
营业收入	2,718,602,121.55	1,863,387,214.10	45.90	1,407,725,738.37
归属于上市公司股东的净利润	601,778,469.15	319,972,560.66	88.07	204,707,014.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	445,544,292.94	271,829,892.38	63.91	176,999,826.26
经营活动产生的现金流量净额	290,371,555.38	560,479,615.19	-48.19	426,701,510.41
加权平均净资产收益率(%)	24.05	15.32	增加8.73个百分点	12.69
基本每股收益(元/股)	1.45	0.79	83.54	0.55
稀释每股收益(元/股)	1.45	0.79	83.54	0.55

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	564,992,405.58	813,422,220.37	678,601,519.71	661,585,975.89
归属于上市公司股东的净利润	111,661,341.20	153,189,543.65	142,848,889.98	194,078,694.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	81,176,835.47	137,253,763.33	125,947,415.18	101,166,278.96
经营活动产生的现金流量净额	-581,485.69	116,424,172.33	176,404,429.32	-1,875,560.58

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	22,082
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	24,377
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
励民	0	157,679,892	37.79	157,679,892	无	0	境内自然人
黄旭	0	66,600,108	15.96	66,600,108	无	0	境内自然人
厦门市润科欣投资管理合伙企业(有限合伙)	-2,613,700	30,777,740	7.38	0	无	0	境内非国有法人
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	-5,418,451	20,501,149	4.91	0	无	0	国有法人
上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业(有限合伙)	0	19,585,000	4.69	0	无	0	境内非国有法人
平潭腾兴众和投资合伙企业(有限合伙)	-5,037,190	15,115,610	3.62	0	无	0	境内非国有法人
厦门普芯达投资合伙企业(有限合伙)	-4,046,700	12,140,340	2.91	0	无	0	境内非国有法人
厦门芯翰投资合伙企业(有限合伙)	-2,816,183	8,452,537	2.03	0	无	0	境内非国有法人
招商银行股份有限公司-银河创新成长混合型证券投资基金	6,562,315	6,562,315	1.57	0	无	0	其他
交通银行股份有限公司-万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)	5,000,023	5,000,023	1.20	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	励民、黄旭为一致行动人,公司控股股东、实际控制人。上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业(有限合伙)、北京中清正合科技创业投资管理有限公司-北京武岳峰齐合高科技产业投资合伙企业(有限合伙)为一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入2,718,602,121.55元,同比增长45.90%,归属上市公司股东净利润 601,778,469.15元,同比增长88.07%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603893　证券简称:瑞芯微　公告编号:2022-017

瑞芯微电子股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

瑞芯微电子股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第九次会议通知和材料于2022年3月11日以邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出,会议于2022年3月21日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。会议应出席董事5名,实际出席董事5名,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长励民先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于(2021年年度报告)及其摘要的议案》

公司2021年年度报告的编制符合法律、行政法规、公司章程、公司内部管理制度的各项规定,公司严格按照上市公司财务制度规范运作,2021年年度报真实、全面地反映了本报告期的财务状况和经营成果。

2021年年度报告编制过程中,未发现公司参与2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

公司全体董事保证公司2021年年度报告全文及其摘要所披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

《瑞芯微电子股份有限公司2021年年度报告》全文同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),《瑞芯微电子股份有限公司2021年年度报告摘要》同日刊登于《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.审议通过《关于(2021年度财务决算报告)的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3.审议通过《关于(2021年度董事会工作报告)的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4.审议通过《关于(2021年度总经理工作报告)的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

5.审议通过《关于(2021年度董事会工作报告)的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6.审议通过《关于(2021年度董事会审计委员会履职情况报告)的议案》

《2021年度董事会审计委员会履职情况报告》全文同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

7.审议通过《关于(2021年度独立董事述职报告)的议案》

《2021年度独立董事述职报告》全文同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8.审议通过《关于(2021年度内部控制评价报告)的议案》

董事会认为,根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制;根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷;自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

《2021年度内部控制评价报告》全文同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

9.审议通过《关于(2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)的议案》

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《瑞芯微电子股份有限公司 2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-020)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

10.审议通过《关于公司董事薪酬方案的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

11.审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

12.审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司董事会同意为提高公司资金使用效率,增加资金收益,实现股东利益最大化,在不影响公司的正常经营和确保资金安全的前提下,使用额度不超过20亿元的闲置自有资金进行现金管理,择机购买低风险、流通性高的投资理财产品,投资期限为自公司股东大会审议通过之日起一年内有效,公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。在上述有效期及额度范围内,公司董事会提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,具体包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方,明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《瑞芯微电子股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-021)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

13.审议通过《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予第一个行权期行权条件及第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《瑞芯微电子股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案二次修订稿)》《瑞芯微电子股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法(二次修订稿)》的有关规定及公司2020年第三次临时股东大会的授权,现认为公司2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予第一个行权期行权条件及第一个解除限售期解除限售条件均已成就。本次符合行权条件的股票期权激励对象为45名,拟行权数量为6.84万份,第一个行权期可行权数量占已获授股票期权比例为30%;本次符合限制性股票解除限售条件的激励对象为56名,拟解除限售数量为27.03万股,第一个解除限售期解除限售股票比例为30%。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《瑞芯微电子股份有限公司关于2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予第一个行权期行权条件及第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》(公告编号:2022-022)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

特别公告

瑞芯微电子股份有限公司董事会

2022年3月22日

证券代码:603893　证券简称:瑞芯微　公告编号:2022-018

瑞芯微电子股份有限公司 关于2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予第一个行权期行权条件及第一个解除限售期解除限售条件成就的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次符合股票期权行权条件的激励对象为45人;本次符合限制性股票解除限售条件的激励对象为56人。

●限制性股票拟解除限售数量:27.03万股,占截至2021年12月31日公司股本总额的41,725,12万股的0.06%。

●股票期权拟行权数量:6.84万份,行权价格为65.78元/份。

●行权股票来源:公司向激励对象定向发行公司股票。

●本次股票期权行权与限制性股票解除限售事宜尚需向有关机构申请办理相关手续后方可行权和解除限售。

瑞芯微电子股份有限公司(以下简称"公司")于2022年3月21日分别召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议,审议通过《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予第一个行权期行权条件及第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。现对有关事项说明如下:

一、2020年股票期权与限制性股票激励计划批准及实施情况

(一)2020年股票期权与限制性股票激励计划已履行的审议程序

1.2020年5月21日,公司召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第六次会议,分别审议通过《关于(福州瑞芯微电子股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于(福州瑞芯微电子股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》等相关议案。公司独立董事对本次股权激励计划相关事项发表了独立意见。监事会对本次股权激励计划相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2.2020年6月18日,公司召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第八次会议,审议通过《关于(瑞芯微电子股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿))及其摘要的议案》及相关事项的议案。

3.2020年9月4日,公司对激励对象名单在公司内部进行了公示,公示时间为2020年9月4日至2020年9月13日,在公示期间公司监事会未接到任何组织或个人对公司本次激励对象提出的异议。公示期满后,公司于2020年9月15日披露了《瑞芯微电子股份有限公司监事会关于2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

4.2020年9月21日,公司召开2020年第三次临时股东大会,审议通过《关于(瑞芯微电子股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿))及其摘要的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》等相关事项的议案,并披露了《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划内幕知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5.2020年9月21日,公司分别召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十会议,审议通过《关于调整2020年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的议案》以及《关于向激励对象首次授予2020年股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对本激励计划授予相关事项发表了核查意见。

6.2020年11月6日,公司完成了2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予登记手续。首次实际授予股票期权数量为187.50万份,行权价格为 63.00元/份,首次实际授予限制性股票数量为359.80万股,授予价格为31.50元/股。

7.2021年1月28日,公司分别召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十四会议,审议通过《关于修订公司2020年股票期权与限制性股票激励计划中预留部分相关内容的议案》《关于向激励对象授予2020年股票期权与限制性股票激励计划部分预留权益的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对本激励计划授予预留部分权益的相关事项发表了核查意见。

8.2021年3月24日,公司完成了2020年股票期权与限制性股票激励计划部分预留权益的授予登记手续。预留实际授予股票期权数量为25.20万份,行权价格为66.28元/份,预留实际授予限制性股票数量为92.90万股,授予价格为33.14元/股。

9.2021年9月23日,公司披露了《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划剩余预留权益失效的公告》。